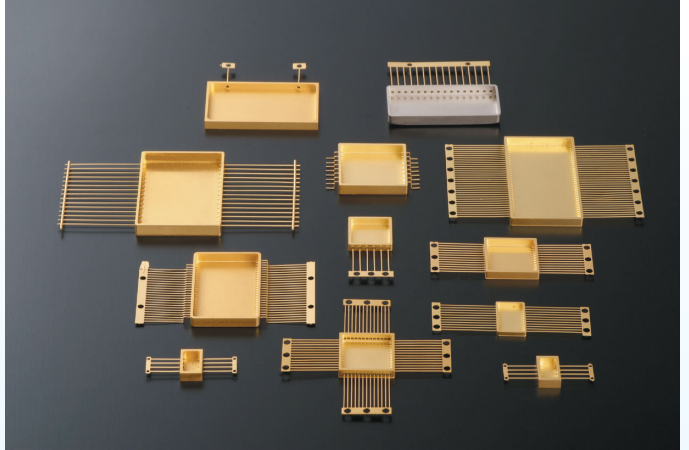


フラットパッケージ

これらのパッケージは金属とガラスで製作されており気密性及び絶縁性に優れております。面実装タイプのHIC用パッケージなどに用いられております。

主な特徴

- ・気密性： $1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下。
- ・絶縁抵抗：ベースリード線間DC500Vにて1000M以上。
- ・仕上げ：Ni-Ep / Ni-Elp+Au-Ep
- ・MIL-STD-883規格に準拠した評価も提供可能です。
- ・リッド(カバー)とセットにしても提供いたします。
- ・代表的概要図を以下に示しておりますが、特注(カスタム)の設計・製作も致しますので、別途ご相談ください。



ハイブリッドIC用パッケージ

代表的製品の概略図

